

2.5D 実装に最適なインターポーザ技術

福岡 義孝*, 倉持 悟**, 鈴木 浩助**

Interposer Technology Development Which is the Most Appropriate for 2.5D Packaging

Yoshitaka FUKUOKA*, Satoru KURAMOCHI**, and Kousuke SUZUKI**

* ウェイステイ (〒192-0352 東京都八王子市大塚 293-64)

** 大日本印刷株式会社・研究開発センター・次世代 MEMS 研究所 (〒277-0871 千葉県柏市若柴 250-1)

* WEISTI (Worldwide Electronic Integrated Substrate Technology Inc.) (293-64, Otsuka, Hachioji-shi, Tokyo 192-0352)

** Next Generation MEMS Laboratory, Research & Development Center, DNP (Dai Nippon Printing Co., Ltd.) (250-1, Wakashiba Kashiwa-shi, Chiba 277-0871)